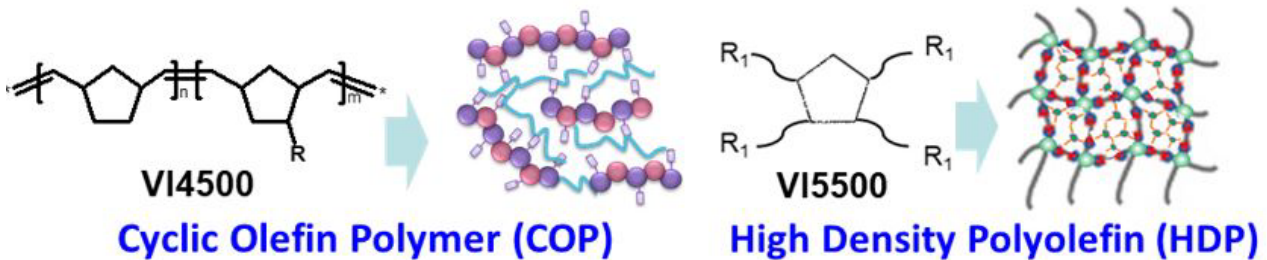
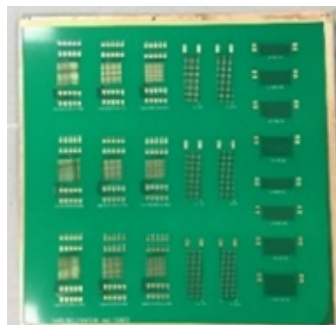


## 技術特色

5G應用的崛起驅動電子產業技術朝高頻高速化發展，相關電路板元件走向可支援毫米波頻段的材料系統，其中的關鍵材料-銅箔基板能否因應高速資訊的處理和大量數據傳輸的需求，實為各材料領域積極突破的目標，本技術涵蓋低損耗樹脂、銅箔基板配方和製程之開發。



銅箔基板



電路板

基板材料特性	
Dk/Df @10GHz*	2.9/0.0014
Dk/Df @38GHz**	3.1/0.0020
T <sub>g</sub> (°C)	202
Peel Strength (lb/in)	3.5 (0.5oz, HVLP2)
Moisture Absorption	0.21 (PCT 2hrs)
Solder dip (after PCT 2hrs)	Pass